

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

截至2026年6月30日止6個月

中期業績公告

財務摘要

- 銷售額下跌約4.8%至43.7百萬美元
- 毛利為12.0百萬美元，毛利率為27.4%
- 本公司擁有人應佔期內損失淨額為4.0百萬美元
- 每股基本／攤薄損失為0.16美仙（等同於1.24港仙）

中期業績

晶門半導體有限公司(統稱「本公司」)的董事宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2026年6月30日止6個月的未經審核簡明綜合中期業績連同上年度同期的比較數字列載如下：

中期簡明綜合損益表

截至2026年6月30日止6個月

		未經審核	
		6月30日止6個月	
	附註	2026 千美元	2025 千美元
銷售額	4	43,723	45,934
銷售成本		(31,742)	(27,759)
毛利		11,981	18,175
其他收入及收益－淨額		250	514
研究及開發成本		(10,246)	(9,943)
銷售及分銷開支		(1,712)	(1,640)
行政及一般開支		(5,299)	(5,207)
外匯差額－淨額		(456)	81
其他開支		(23)	—
		(5,505)	1,980
投資收入－淨額	6	1,552	2,080
		(3,953)	4,060
應佔聯營公司盈利		—	44
除稅前(損失)／溢利	5	(3,953)	4,104
所得稅開支	7	—	(101)
期內本公司擁有人應佔(損失)／溢利		(3,953)	4,003
本公司普通權益持有人應佔的每股(損失)／溢利：(美仙)	8		
— 基本		(0.16)	0.16
— 攤薄		(0.16)	0.16

中期簡明綜合全面收入報表

截至2026年6月30日止6個月

	未經審核	
	6月30日止6個月	
	2026	2025
	千美元	千美元
期內(損失)／溢利	(3,953)	4,003
其他全面收益		
於往後期間，其他全面收益將重新分類至損益表：		
－ 換算海外業務時之匯兌差額	1,301	78
期內本公司擁有人應佔全面(損失)／收益總計	(2,652)	4,081

中期簡明綜合財務狀況表

於2026年6月30日

		未經審核 6月30日 2026 千美元	經審核 12月31日 2025 千美元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		5,710	6,196
使用權資產		1,675	2,237
於聯營公司的投資		1,092	1,092
按公平價值計入其他全面收益的金融資產		1,219	1,219
其他應收款，預付款及訂金	10	104	456
非流動資產總計		9,800	11,200
流動資產			
存貨		14,005	18,294
應收款及其他應收款、預付款項及訂金	10	29,791	28,316
已抵押的銀行存款		2,500	2,500
現金及現金等價物		107,982	104,413
流動資產總計		154,278	153,523
流動負債			
應付款及其他應付款	11	22,527	19,904
租賃負債		1,337	1,494
應付稅款		537	514
流動負債總計		24,401	21,912
流動資產淨值		129,877	131,611
總資產減流動負債		139,677	142,811
非流動負債			
租賃負債		454	936
非流動負債總計		454	936
資產淨值		139,223	141,875
權益			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本		32,193	32,193
儲備		107,030	109,682
總權益		139,223	141,875

中期簡明綜合財務資料附註

1. 一般資料

晶門半導體有限公司及其附屬公司為無晶圓廠半導體集團，專門設計、開發及銷售集成電路晶片產品及系統解決方案，能廣泛應用於智能手機、平板電腦、電視／顯示器、筆記本電腦以及其他智能產品，包括電子貨架標籤，可穿戴產品、醫療保健設備、智能家居設備，以及工業用設備等作各類顯示及觸控應用。

本公司於2003年11月21日根據開曼群島公司法（1961年法律3，經綜合及修訂）第22章在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處的地址為P.O. Box 31119, Grand Pavilion Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205，開曼群島，而其香港總辦事處的地址為香港新界沙田香港科學園科技大道東3號無線電中心6樓607-613室。

本公司自2004年4月8日起，在香港聯合交易所有限公司主板上市。除另有列明外，本中期簡明綜合財務資料均以美元作呈列單位。

本中期簡明綜合財務資料乃經審閱但未經審核，並於2026年8月21日獲批准刊發。

2. 編製基準

本集團截至2026年6月30日止6個月（「回顧期內」）的中期簡明綜合財務資料已根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。中期簡明綜合財務資料並沒有載有一般收錄於年度綜合財務報表之所有資料及附註，故此，應與本集團截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表一併閱讀。

3. 重大會計政策

編製本中期簡明綜合財務資料時採用的會計政策與編製截至2025年12月31日止年度的本集團年度綜合財務報表時採用的會計政策一致，但本期財務資料首次採用以下經修訂香港財務報告會計準則。

香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號之修訂	金融工具分類與計量之修訂
香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號之修訂	涉及依賴自然能源生產電力的合約
香港財務報告會計準則之年度改進 — 第11冊	香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第7號、 香港財務報告準則第9號、香港財務報告準則第10號 及香港會計準則第7號之修訂

經修訂香港財務報告會計準則的性質及影響說明如下：

- (a) 香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號之修訂金融工具分類與計量之修訂澄清當實體對合約現金流量的權利屆滿或被轉讓時，金融資產予以終止確認，而金融負債則於結算日期終止確認。該等修訂引入一項會計政策選擇，在達致特定標準的情況下，終止確認於結算日期之前通過電子支付系統結算的金融負債。該等修訂澄清如何評估具有環境、社會及管治以及其他類似或然特性的金融資產的合約現金流特性。此外，該等修訂澄清對具有無追索權特性的金融資產及合約掛鉤工具進行分類的規定。該等修訂亦包括對指定為按公平價值計入其他全面收益的股權工具及具有或然特性的金融工具之投資的額外披露規定。

在首次應用該等修訂前，本集團向債權人開立支票時，會終止確認以支票結算的應付款。應用該等修訂後，以支票結算的應付款將於結算日期（即銀行清算支票當日）終止確認。該會計政策變動對本集團中期簡明綜合財務資料並無重大影響。該會計政策變動將反映於本集團截至2026年12月31日止年度的綜合財務報表。

- (b) 香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號之修訂涉及依賴自然能源生產電力的合約澄清範圍內合約「自用」規定的應用，並修訂範圍內合約現金流量對沖關係中指定的被對沖項目的規定。該等修訂本亦包括額外披露，使財務報表使用者能夠了解該等合約對實體財務表現及未來現金流量的影響。由於本集團並無任何合約屬於該等修訂的適用範圍，因此該等修訂對中期簡明綜合財務資料並無任何影響。
- (c) 香港財務報告會計準則之年度改進—第11冊載列香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第7號（及隨附的實施香港財務報告準則第7號指引）、香港財務報告準則第9號、香港財務報告準則第10號及香港會計準則第7號所作出的範圍有限的修訂。該等修訂包括為提高相關香港財務報告會計準則的一致性而作出的澄清、簡化、更正或變更。該等修訂對中期簡明綜合財務資料並無任何影響。

4. 分部資料及銷售額分類

本集團主要從事設計、開發、銷售專有IC產品及系統解決方案，能廣泛應用於智能手機、平板電腦、電視／顯示器、筆記本電腦以及其他智能產品，包括電子貨架標籤，可穿戴產品、醫療保健設備、智能家居設備，以及工業用設備等作各類顯示及觸控應用。

本集團一直以單一營運分部經營，即設計、開發及銷售專有IC產品及系統解決方案。

本集團最高營運決策層為本集團行政總裁暨領導下的執行董事和高級管理層。執行董事和高級管理層檢討本集團內部報告以評估業績及分配資源。管理層基於該等報告確定營運分部報告。

截至2026年6月30日止6個月，銷售額為43,723,000美元（2025年上半年：45,934,000美元）。

本集團主要於香港經營其業務。於回顧期內，本集團之產品主要銷售予位於香港、歐洲及台灣的客戶。

(a) 按地域市場分類的客戶合約收益

	未經審核 6月30日止6個月	
	2026 千美元	2025 千美元
香港	24,908	28,033
歐洲	6,282	7,243
台灣	7,184	7,029
日本	2,138	2,316
中國內地	3,033	1,142
韓國	119	66
東南亞	4	21
美國	1	—
其他	54	84
	43,723	45,934

銷售額按客戶所在地區／國家分類。

(b) 按產品種類分類的客戶合約收益

	未經審核 6月30日止6個月	
	2026 千美元	2025 千美元
新型顯示ICs	28,149	29,621
OLED顯示ICs	7,738	7,270
移動顯示及移動觸碰ICs	4,046	5,879
大型顯示ICs	3,790	3,164
	43,723	45,934

(c) 非流動資產

	未經審核 6月30日 2026 千美元	經審核 12月31日 2025 千美元
香港	1,245	1,638
中國內地	5,719	6,283
台灣	1,513	1,604
	8,477	9,525

非流動資產（不包含金融資產）乃根據資產的所在地予以列載。

(d) 資本開支

	未經審核 6月30日止6個月	
	2026	2025
	千美元	千美元
物業、廠房及設備		
中國內地	14	1,777
香港	109	47
台灣	—	15
	123	1,839

資本開支是根據資產的所在地予以列載。

(e) 主要客戶

截至2026年6月30日止6個月，最大及第二大客戶分別位於香港及歐洲。其銷售額分別為21,880,000美元及4,582,000美元，並各佔本集團總銷售額超過10%。截至2025年6月30日止6個月，最大及第二大客戶分別位於香港及歐洲。其銷售額為23,872,000美元及5,912,000美元，並各佔本集團總銷售額超過10%。

5. 除稅前(損失)/溢利

本集團的除稅前溢利乃扣除/(計入)下列各項後得出：

	未經審核 6月30日止6個月	
	2026	2025
	千美元	千美元
銷貨成本	31,227	29,521
過時或滯銷存貨的撥備/(撥備回撥)淨額	41	(2,213)
物業廠房設備折舊(附註一)	788	816
使用權資產折舊(附註二)	650	699

附註一： 折舊開支410,000美元(2025年上半年：389,000美元)已於銷售成本中支銷，而42,000美元(2025年上半年：53,000美元)則於研究及開發成本中入賬及336,000美元(2025年上半年：374,000美元)於行政開支中入賬。

附註二： 使用權資產折舊64,000美元(2025上半年：62,000美元)已計入中期簡明綜合損益表內銷售成本。

6. 投資收入－淨額

	未經審核 6月30日止6個月	
	2026 千美元	2025 千美元
利息收入	1,607	2,171
銀行貸款的利息支出	—	(5)
租賃負債的利息支出	(55)	(86)
	1,552	2,080

7. 所得稅

本集團於香港概無評稅利潤，概無作本期間香港所得稅撥備。於往年本集團因有承前自以往年度之可動用稅務虧損可用以抵銷期內香港產生之應課稅溢利，因此並無作本期間香港利得稅撥備。海外所得稅則根據本集團的營運所在司法權區之適用稅率計算。

	未經審核 6月30日止6個月	
	2026 千美元	2025 千美元
即期－其他地區－所得稅		
－本期支出	—	101
本期所得稅開支總額	—	101

8. 每股(損失)/盈利

(a) 每股基本(損失)/盈利

每股基本(損失)/盈利是根據本公司的擁有人應佔本集團之(損失)/溢利及本期內已發行普通股加權平均數2,497,752,351股(2025上半年：2,497,752,351股)計算。

本公司的擁有人期內應佔本集團之損失為3,953,000美元(2025上半年：溢利4,003,000美元)。

(b) 每股攤薄(損失)/盈利

每股攤薄(損失)/盈利乃根據本公司的擁有人應佔本集團之(損失)/溢利及已就期內所有具潛在攤薄影響的普通股作出調整後之已發行加權平均普通股數計算。

加權平均普通股股數的有關資料列載如下：

	股份數目 未經審核 6月30日止6個月	
	2026	2025
已發行加權平均普通股 股數	2,497,752,351	2,497,752,351
兌換所有可予發行具攤薄影響的流通購股權 ⁽ⁱ⁾	—	—
用作計算每股攤薄盈利的調整後加權平均普通股股數	2,497,752,351	2,497,752,351

- (i) 於2026年6月30日止之250,000份（於2025年6月30日止500,000份）尚未行使的購股權並未進行攤薄調整，因該等購股權並無攤薄效應。

9. 股息

董事會決議不宣派截至2026年6月30日止6個月的中期股息（截至2025年6月30日止6個月：無）。

10. 應收款及其他應收款、預付款項及訂金

	未經審核 6月30日 2026 千美元	經審核 12月31日 2025 千美元
應收款	9,486	9,605
關聯方應收款	10,894	13,806
減值撥備	(241)	(215)
應收款－淨額	20,139	23,196
其他應收款、預付款項及訂金	9,561	4,906
關聯方預付款	100	226
減值撥備	(9)	(12)
應收款及其他應收款、預付款項及訂金		
－流動	29,791	28,316
其他應收款、預付款項及訂金		
－非流動	104	456
	29,895	28,772

於2026年6月30日，本集團對企業客戶之應收款信貸期主要為30至90日。應收款以發票日期及扣除減值撥備的賬齡分析如下：

	未經審核 6月30日 2026 千美元	經審核 12月31日 2025 千美元
1–30日	11,628	14,675
31–60日	4,236	3,598
61–90日	2,143	4,022
91–180日	297	670
181–360日	1,835	—
超過360日	—	231
	20,139	23,196

應收款減值撥備變動如下：

	未經審核 6月30日 2026 千美元	經審核 12月31日 2025 千美元
於期初／年初	215	201
減值	26	14
於期末／年末	241	215

11. 應付款及其他應付款

	未經審核 6月30日 2026 千美元	經審核 12月31日 2025 千美元
應付款	6,848	5,973
關聯方應付款	71	3
	6,919	5,976
應計開支及其他應付款	13,472	11,941
合約負債	716	621
退款負債	1,420	1,366
	22,527	19,904

於2026年6月30日，應付款以發票日期的賬齡分析如下：

	未經審核 6月30日 2026 千美元	經審核 12月31日 2025 千美元
1–30日	3,757	2,875
31–60日	1,991	1,457
61–90日	718	1,028
超過90日	453	616
	6,919	5,976

管理層討論及分析

業務回顧及展望

業務回顧

2026年上半年，受AI相關設備投資拉動，導致GPU、記憶體、儲存以及電源相關IC需求持續增長，帶動晶圓代工產能需求維持高位。由於相關產品與顯示驅動IC共享部分晶圓製造資源，晶圓廠產能利用率長期高企致晶圓價格上升，增加本集團的生產成本。面對市場環境變化，本集團持續優化產品組合、加強供應鏈管理及推行成本控制措施，以提升營運效率。然而，晶圓及黃金價格上漲仍對本集團毛利率及盈利能力帶來一定影響。

截至2026年6月30日止六個月（「期內」），本集團付運量較去年同期（159.7百萬件）減少約3.8%至約153.7百萬件，主要由於新一代產品推出時間較原定計劃延後，惟部分影響已被其他產品投入量產所抵銷。

受終端產品持續降價及市場競爭加劇影響，產品平均售價有所下跌，加上付運量輕微減少，本集團銷售收入較去年同期（45.9百萬美元）減少約4.8%至43.7百萬美元。此外，受晶圓成本增加及黃金價格上升影響，本集團於期內的毛利率下降至27.4%。

受惠於部分產品於2026年第二季起陸續投入量產，加上成本控制措施逐步見效，本集團第二季度相對第一季表現已有明顯改善。然而，由於生產成本較去年同期上升，本集團於期內仍錄得虧損。

展望下半年，隨著新產品陸續推出市場及相關項目逐步量產，加上市場推廣工作穩步推進，本集團預期收入及經營表現有望逐步改善。本集團將繼續優化產品組合、強化供應鏈管理、加強成本控制及產能部署，以提升整體營運效益及市場競爭力。

新型顯示IC

新型顯示IC產品主要指本集團之雙穩態顯示產品。雙穩態顯示是一種非傳統的顯示技術，顯示設備通過反射環境光來照明。

電子貨架標籤既能靈活更新價格、提高效率，亦易於庫存管理，不僅可降低長期成本，更可減少商戶的碳足跡，迎合無紙化可持續發展的全球趨勢。眾多優點令電子貨架標籤不僅在歐洲及北美普及，近年在亞洲國家亦成為新興趨勢。本集團早著先機，多年來專注發展電子貨架標籤IC產品，相關方案已獲全球多家領先超級市場採用。

市場上的三色(E4)、四色(E5)電子顯示標籤已完成更新換代，本集團亦已完成四色顯示標籤所有型號的制式更新。與此同時，市場正朝著更多色彩顯示規格發展，以滿足零售商對提升顧客體驗及產品差異化的需求。為配合市場升級趨勢，本集團積極開發新一代彩色電子顯示標籤IC產品，專注於支援七色及以上顯示效果的E5(3-bit)及E6電子紙應用。期內，本集團已成功推出該系列IC產品，包括SSD2692、SSD2693、SSD2695、SSD2690和SSD2696(3-bit)，並已獲客戶導入模組設計，為未來量產及市場滲透奠定基礎。

期內，本集團新型顯示IC產品的付運量較去年同期輕微下跌。受市場競爭加劇及產品平均售價下降影響，相關業務收入亦較去年同期錄得輕微跌幅。此外，由於晶圓供應持續緊張及生產成本上升，相關產品毛利率亦較去年同期有所回落。下半年起，本集團已與主要晶圓供應商訂立中長期供應協議，預期晶圓供應將會相對穩定。

除標準IC產品外，本集團亦積極與客戶合作開展定制化IC項目，包括採用GOA(Gate-on-Array)技術開發不同應用方案，以提升產品差異化及滿足客戶多元化需求。本集團將因應市場需求持續豐富定制化IC產品組合，進一步拓展業務機會及增強市場競爭力。

另一方面，本集團持續推動電子紙技術於電子貨架標籤以外的應用領域。配合元太科技Prism™ 3多色電子紙薄膜技術的發展，該段碼技術可為家電、車身、室內裝飾和穿戴式產品等不同領域和應用實現顏色動態變化，令產品更個性化。Prism™ 3不但可以自由切割，而且可以貼附於立體表面，大大提高了應用的彈性和可能性。本集團正開發配套驅動IC產品，樣品預計於2026年第三季度完成，進一步拓展電子紙技術於消費、智能家居及工業市場的應用機遇。

展望下半年，受惠於彩色電子紙技術持續升級，以及終端客戶對顯示效果及產品差異化需求日益增加，電子紙市場預期將保持穩步發展。本集團將持續推進新產品開發及應用拓展，並深化與客戶及產業鏈夥伴的合作，以把握相關市場機遇。

與此同時，受晶圓需求持續高企及產能供應緊張影響，預期下半年生產成本仍將維持於較高水平，而產品價格亦將因應整體供需環境變化而有所調整。本集團將透過優化供應鏈管理、強化成本控制及提升營運效率，減輕成本上升對業務表現的影響，並鞏固長遠發展基礎。

OLED顯示IC

晶門半導體提供多種OLED顯示驅動IC，應用廣泛，包括被動式OLED（「PMOLED」）、mini/micro-LED和圖標IC (icon IC)產品等。集團是全球最大的PMOLED顯示驅動IC廠商，按期內付運量計算，市場份額佔主導地位。本集團提供從圖標到點陣，從單色和灰階顯示到全彩色高度集成的全系列PMOLED驅動IC，是便攜式設備的理想顯示解決方案。期內，受無人機及運動相機項目進入量產階段帶動，本集團OLED顯示IC的付運量及銷售收入均錄得增長。

本集團提供一系列具價格競爭力的圖標IC，自2023年產品推出至今，該產品之客戶持續就使用了此系列圖標IC的終端產品進行推廣。本集團的圖標IC針對1至4英寸的顯示器，除應用於便攜式產品，亦可為本集團拓闊智能家電的大面板市場。智能家電產品在市場上已是大勢所趨，本集團將繼續關注持續增長的智能家居解決方案和物聯網(IoT)的市場需求。本集團並於期內繼續推廣其新研發可支持PMOLED透明顯示屏的IC產品，透明PMOLED顯示屏是一種新型技術，可應用於潛水鏡、高爾夫球探球眼鏡等需要透明顯示的終端應用。此外，一款OLED產品亦成功獲遊戲終端產品客戶採用於模組設計，預期將於下半年投入量產，為業務增長提供支持。

本集團亦是mini/micro-LED應用的先行者，用於50至100英寸室內顯示標牌的mini-LED DDI解決方案自2018年至今一直在量產，現時由美國電影製片廠採用，用於打造拍攝現場的動態虛擬場景。本集團於2023年推出全球首枚小尺寸被動式microLED顯示驅動IC—SSD2363，該產品可應用於3英寸或以下的新一代高亮度16.7M彩色顯示屏，適用於穿戴裝置、家用電器及工業應用。此IC產品現時以供客戶驗證測試其終端產品micro-LED功能的用途為主，本集團亦正積極接觸不同類型的客戶，以推動相關產品應用到各高增值項目，例如便攜式電子產品市場等。

另一方面，因部分晶圓代工廠調整產能配置，導致市場上8吋晶圓供應減少，令8吋晶圓供應趨於緊張，對OLED顯示IC產品的供應鏈管理帶來一定挑戰。為確保產品供應穩定及滿足客戶需求，本集團已採取適當的產能調配及佈局措施，包括與晶圓廠訂立中長期協議以穩定供應，相關安排進展順利，預期將於未來陸續為產品供應提供支持，並有助提升供應保障能力及營運韌性。憑藉穩定的客戶基礎及持續推出新產品，本集團將繼續把握無人機、智能設備及其他高增值應用市場的發展機遇。

移動顯示及移動觸控IC

晶門半導體提供多種移動顯示及移動觸控IC解決方案，不斷擴闊產品組合，包括內嵌式觸控顯示驅動IC、TFT顯示驅動IC、STN顯示驅動IC、MIPI橋接IC和顯示控制IC，支持廣泛的工業和消費產品，如智能手機、平板電腦、可穿戴設備、遊戲裝置和物聯網設備等。本集團是MIPI顯示解決方案的先驅，提供一系列專有功能，支持智能設備的高分辨率、高速和低功耗顯示。

期內，本集團移動顯示及觸控IC產品的付運量及銷售收入均較去年同期下跌，主要由於記憶體及固態硬碟等關鍵元件價格上升，推高終端產品整體成本及零售價格，影響市場需求；加上部分供應鏈限制對出貨造成影響，令相關產品銷售表現較去年同期有所回落。

本集團在TDDI技術領域擁有豐富經驗，設計的遊戲控制器IC能讓操控更準確、反應更快捷而電池運行時間更長。憑藉相關技術優勢，本集團積極關注消費市場及車載顯示等高增值應用領域的發展機遇，以及高亮度及戶外顯示場景的市場需求變化，以進一步提升產品競爭力。然而，應用於車用HUD抬頭顯示器的LoD局部調光橋接IC開發工作持續推進，相關樣品預計將於年內完成。

展望下半年，本集團持續拓展移動顯示及移動觸控IC應用到更多不同領域，包括積極爭取下一代遊戲控制器設計項目，以延長產品生命週期及爭取更多市場份額。此外，本集團將加快車用HUD抬頭顯示器（LoD局部調光橋接IC）的開發及測試工作，並力爭於2026年第四季度完成相關SoC樣品推出，積極向客戶推廣並爭取項目機會。本集團將繼續接觸生產不同終端產品的客戶，以收集和了解其需求來開發出切合個別應用的產品。

大型顯示IC

本集團致力於與國內外顯示屏大廠開發多種大尺寸顯示驅動 IC 解決方案，支持商用顯示器、高階電競顯示器、各尺寸智能電視，以及中、大型彩色電子紙標牌、電子紙佈告欄、電子書閱讀器和電子錢包等應用。

期內，本集團大型顯示IC業務表現穩定，新型彩色電子紙顯示產品持續出貨，其中已量產的Gallery 3彩色電子紙筆記本方案持續獲市場採用，為相關業務帶來穩定收入貢獻，並帶動付運量較去年同期有所增長。

在電子紙顯示市場方面，本集團積極採用miniLVDS介面的大尺寸彩色電子紙顯示驅動IC解決方案，目標涵蓋20吋至75吋智慧媒體電子標牌／戶外電子標牌(Spectra™ 6)應用。期內，相關方案已展開不同尺寸產品的終端驗證工作，部分尺寸產品已成功投入量產，其餘尺寸產品預計將於下半年開始量產出貨。同時，本集團正推進16灰階電子紙錢包及單晶片高分辨率黑白整合式(All-in-One)晶片解決方案，相關產品預計於2026年第四季度推出市場，以把握便攜式電子紙設備市場的增長機遇。

展望下半年，本集團將繼續爭取更多晶圓產能，以支持電子紙筆記本及電子紙標牌等量產項目，滿足客戶需求增長。同時，本集團將加快推廣E6電子紙顯示驅動方案，除現有量產項目外，亦積極拓展至更多顯示面板廠商及終端應用客戶，進一步擴大市場覆蓋。另一方面，單晶片高分辨率黑白整合式晶片方案將按計劃推進，配合客戶於第四季度量產出貨。此外，本集團正規劃開發應用於大尺寸電子紙標牌的AIO(All-in-One)整合式電子紙驅動晶片，預計於2026年第三季度啟動開發，並於2027年提供樣品，進一步完善產品佈局，為未來業務發展創造新增長動力。

展望

展望下半年，全球經濟及地緣政治環境仍存在不少不確定因素。美國關稅政策及貿易措施變化頻繁，或對全球供應鏈及市場需求帶來影響。同時，GPU、記憶體、儲存以及電源相關IC需求持續強勁，帶動晶圓代工產能維持緊張，預期將繼續為顯示驅動IC產業帶來成本壓力。面對複雜的經營環境，本集團將持續優化產品組合及供應鏈佈局，並加強成本控制及營運效率，以提升整體競爭力。

產品發展方面，本集團將繼續聚焦電子紙、OLED顯示及其他高增值應用市場。在電子紙業務方面，七色電子顯示標籤、Gallery 3彩色電子紙筆記本、單晶片高分辨率黑白整合式(All-in-One)晶片，以及E6電子紙標牌驅動方案等產品將陸續進入客戶驗證、導入及量產階段，有望為集團帶來新的收入來源。同時，本集團亦將持續推進Prism™ 3、GOA技術及其他定制化IC項目開發，進一步拓展電子紙技術於消費電子、智能家居及工業應用等領域的市場機遇。除此以外，應用於車用HUD抬頭顯示器（LoD局部調光橋接IC）的mini-LED背光方案亦將於下半年推出市場。

本集團憑藉充足的資源、穩健的技術實力及多元化的產品組合，將繼續推進新產品開發及商業化進程，並深化與客戶及合作夥伴的協作，以把握市場機遇，推動業務穩健發展。

財務回顧

收入及業績回顧

本集團期內收入下跌約4.8%至43.7百萬美元（2025年上半年：45.9百萬美元）。期內本集團的毛利和毛利率分別為12.0百萬美元和27.4%（2025年上半年：分別為18.2百萬美元和39.6%）。銷售額、毛利及毛利率減少主要由於生產成本因全球晶片生態系統中的半導體產業鏈出現瓶頸而增加，產出即使在需求增長的情況下受限。

銷售及分銷開支為1.7百萬美元較去年增加4.4%，行政及一般開支為5.3百萬美元，較去年同期增加1.8%。本集團將繼續實施現行有效且嚴格的成本控制措施以提高營運效率。

本集團已將資源投放在更貼近全球市場趨勢的產品上，在產品工程研發支出方面保持審慎。其於期內的工程研發費用為10.2百萬美元（2025年上半年：9.9百萬美元），上升3.0%，約佔截至2026年6月30日止6個月總銷售額的23.4%（2025年上半年：21.6%），與去年同期比較上升1.8個百分點。為著提高我們的長期競爭力，本集團致力於科研投入，並已創新研發設立宏大目標，務求鞏固於IC顯示器行業的領導地位。

本集團於期內錄得母公司擁有人應佔淨損失為4.0百萬美元（2025年上半年淨溢利：4.0百萬美元）。董事會不建議宣派截至2026年6月30日止6個月的中期股息。

儘管2026年上半年之股東應佔未經審核綜合溢利較2025年上半年有所下降，惟董事會謹此強調，本集團於2026年上半年仍能維持穩定的IC付運量，顯示本集團即使於不利的市場狀況下，仍有能力維持穩定的市場份額。與此同時，我們會繼續投入資源支持本集團不同研發項目以維持本集團的長遠競爭力。

流動資金及財務資源

	未經審核 6月30日 2026 千美元	經審核 12月31日 2025 千美元
流動資產	154,278	153,523
流動負債	24,401	21,912
流動資產淨值	129,877	131,611
流動比率	6.3	7.0

於2026年6月30日，本集團的流動比率為6.3（2025年12月31日：7.0），反映集團財務狀況具有強健的流動資金水平。流動資產淨值所代表的營運資金狀況為129.9百萬美元（2025年12月31日：131.6百萬美元），與去年財務年結相比並無顯著不利變化。

本集團投資於財務資產（主要為銀行存款）作資金管理以獲取利息。於回顧期內，本集團錄得利息收入1,607,000美元（2025年上半年：2,171,000美元）。

庫務管理

本集團設有內部庫務審閱小組（「小組」），負責執行庫務管理政策、審閱整體投資組合及定期監察投資表現以提升現金儲備的回報率。該小組定期與外聘之投資組合管理經理進行會面或電話會議及舉行內部審閱會議以檢討及監察投資表現。

於2026年6月30日，本集團的現金及現金等價物及已抵押銀行存款總計為110.5百萬美元（2025年12月31日：106.9百萬美元），增加3.6百萬美元。當中2.5百萬美元以美元計值（2025年12月31日：2.5百萬美元）屬抵押存款予銀行作融資營運用途。現金及現金等價物和銀行存款主要以美元、新台幣、澳元、港元及人民幣結算。

本集團將繼續分配資源於產品開發、保障產能、擴大顧客群及把握市場及銷售商機、進行若干策略性企業投資及用作一般公司營運用途。本集團亦將繼續執行庫務管理政策，於低利率期間增加現金儲備之回報率。於2026年6月30日，本集團並無任何主要借貸。本集團之現金餘額主要投資於銀行各類存款。

本集團的主要應收及應付款均以美元結算。本集團會密切監察外幣兌換率的變動，以確保能夠以有利的兌換率將美元兌換成其他貨幣，支付當地的營運開支。於回顧期內，由於董事會認為本集團的外匯風險不高，因此本集團並無運用任何衍生工具以對沖其營運方面的外匯風險。

資本開支與或然負債

2026年上半年期間，本集團的資本開支為123,000美元（2025年上半年：1.8百萬元）。

於2026年6月30日，共有1.7百萬美元已商定合約但未撥備之資本開支（2025年12月31日：2.2百萬元）。

除前述之外，本集團概無其他重大資本承擔或或然負債。

收購及出售重大附屬公司及聯營公司

於回顧期內，本集團並無收購或出售任何重大附屬公司及聯營公司。

資產抵押

於2026年6月30日，金額為2.5百萬美元（2025年12月31日：2.5百萬美元）的已抵押銀行存款已抵押予銀行作抵押銀行融資用途。

人力資源及薪酬制度

於2026年6月30日，本集團共有279名員工*。整體員工中約37%駐香港總辦事處，其餘員工分別駐中國內地及台灣。僱員薪金及其他福利由2025年上半年約11.9百萬美元增加至本期間約12.0百萬美元，增加0.8%，僱員薪金及其他福利總額並無重大變化。本集團的薪酬政策乃按個別僱員表現制定，將每年予以檢討。除公積金計劃（根據適用於香港僱員的強制性公積金條例的條款）及政府管理退休金計劃（適用於中國內地及台灣僱員）、醫療及其他保險外，亦會根據個別僱員表現的評估而向僱員授出酌情花紅。

* 數據不包括於中國內地之測試中心

企業管治及補充資料

遵守企業管治守則

董事會及本集團的管理層承諾達到及保持高水平的企業管治，這也是維護業務營運的誠信和保持投資者對本公司信心的關鍵因素。

截至2026年6月30日止6個月期間，本公司一直遵守上市規則附錄C1所載之企業管治守則中所有適用的守則條文。

遵守標準守則

本公司備有就董事及有關員工進行的證券交易的書面指引，條款與上市規則附錄C3所載的規定標準同樣嚴格。本公司已向全體董事作出具體查詢，於截至2026年6月30日止6個月期間，彼等均一直遵守該等指引。

購買、出售或贖回本公司上市股份

於截至2026年6月30日止6個月期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司上市股份。

審閱簡明綜合中期財務資料

審核委員會由2名獨立非執行董事及1名非執行董事組成。未經審核的簡明綜合中期財務資料，已通過管理層聯同審核委員會審閱。

該等未經審核的簡明綜合中期財務資料，已經由本公司獨立核數師安永會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。核數師的獨立審閱報告載於本公司中期報告內。

中期業績於聯交所網站及本公司網站公佈

本公司已於2026年8月21日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.solomon-systech.com)公佈所有根據上市規則規定的本集團的中期財務及相關資料。

代表董事會
晶門半導體有限公司
行政總裁
王華志

香港，2026年8月21日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生（行政總裁）；(b)非執行董事－楊琨先生（主席）、謝鈺鈺先生及劉斐女士；及(c)獨立非執行董事－陳正豪博士、郭海成博士及陳志光先生組成。

釋義及詞彙

董事會	董事會
守則條文	上市規則附錄C1所載之企業管治守則中的守則條文
本公司	晶門半導體有限公司，一家成立於開曼群島的有限公司，其股份於聯交所主板上市
董事	本公司之董事
電子貨架標籤	電子貨架標籤
本集團	本公司及其附屬公司
香港會計準則	香港會計準則
港元	香港元
香港	香港特別行政區
IC	集成電路晶片
上市規則	聯交所證券上市規則
MIPI	移動行業處理器界面
標準守則	上市規則附錄C3所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則
OLED	有機發光二極體
PMOLED	無源矩陣有機發光二極體
中國／中國內地	中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
工程研發	產品設計、開發及工程
聯交所	香港聯合交易所有限公司
TDDI	觸控與顯示驅動器集成
TFT	薄膜電晶體
英國	大英聯合王國
美國	美利堅合眾國
美元	美國元